

2024年3月期

決算説明資料

2024年5月9日

芝浦メカトロニクス株式会社

目次

- 1. 2024年3月期 連結決算概要**
- 2. 2025年3月期 連結業績予想**
- 3. 中期経営計画の進捗**

業績サマリー

■ 通期業績

➤ 営業利益、経常利益は2年連続過去最高益を更新

➤ 前年比 増収増益

売上高 676億円 (11%増)、営業利益 116.9億円 (7%増)

➤ 受注高は618億円、前年比20%減少

半導体分野の後工程では先端パッケージ向けが好調に推移したが、前工程ではウェーハ向けを中心に一部顧客の設備投資計画の見直しなどにより受注減少。
2024年度の受注状況は回復基調。

➤ 期末配当は200円を予定 (前回2月予想から30円増配)

業績結果 (対前年)

(単位：億円)

	2022年度	23/上	23/下	2023年度	対前年増減率
売上高	610	305	371	676	+11%
営業利益	109.1	50.2	66.7	116.9	+7%
R O S	17.9%	16.4%	18.0%	17.3%	-0.6pt
経常利益	105.1	50.3	65.8	116.1	+10%
当期純利益	92.0	38.7	49.2	87.9	-4%
R O E	31.9%	-	-	24.5%	-7.4pt
受注高	768	333	285	618	-20%
F C F	32.0	46.3	-9.7	36.6	+4.6億円

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

■ 売上高

前年比11%増収 (610億円 ⇒ 676億円)

- SPE分野が増加、FPD分野は減少、全体として増収

■ 営業利益

前年比7%増益 (109.1億円 ⇒ 116.9億円)

- SPE分野が増加、FPD分野は減少、全体として増益

■ 当期純利益

前年比4%減益 (92.0億円 ⇒ 87.9億円)

- 前年は繰延税金資産の追加計上 (9.2億円) があったことにより減益

■ 受注高

前年比20%減少 (768億円 ⇒ 618億円)

- 主に半導体前工程で減少

セグメント別業績結果 (対前年) ①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比 17%増 (426億円 ⇒ 501億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやウェーハ向けがいずれも順調で増加。
FPD前工程では、低調で減少。

➤ セグメント利益 前年比 10%増 (96.3億円 ⇒ 106.0億円)

半導体前工程の売上増加により増益。

➤ 受注高 前年比 38%減 (603億円 ⇒ 372億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け及びマスク向けを中心に堅調に推移したが、ウェーハ向けを中心に一部顧客の設備投資計画の見直しなどにより減少。
FPD前工程では、市況の影響を受け低調に推移。

セグメント別業績結果 (対前年) ②

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- 売上高 前年比 12%減 (141億円 ⇒ 124億円)
半導体後工程では、先端パッケージ向けが堅調で増加。
FPD後工程では、前年度受注低調の影響により減少。
真空部門では、半導体向けが堅調で増加。
- セグメント利益 前年比 14%減 (16.9億円 ⇒ 14.5億円)
半導体後工程は売上増加だが、FPD後工程の売上減少により減益。
- 受注高 前年比 44%増 (122億円 ⇒ 176億円)
半導体後工程では、先端パッケージボンダの需要増に伴い大幅に増加。
FPD後工程では、市況の影響を受け減少。
真空部門では、半導体向けを中心に順調に推移。

業績結果 (対前回予想)

*1: 2024年2月公表

(単位: 億円)

	2023年度		
	前回予想 *1	実績	対前回予想 増減率
売上高	660	676	+2%
営業利益	105.0	116.9	+11%
R O S	15.9%	17.3%	+1.4pt
経常利益	100.0	116.1	+16%
当期純利益	74.5	87.9	+18%
R O E	21.0%	24.5%	+3.5pt
受注高	-	618	-

■ 売上高

前回予想比2%増収 (660億円 ⇒ 676億円)

➤ SPE分野が順調に推移

■ 営業利益

前回予想比11%増益 (105億円 ⇒ 116.9億円)

➤ 売上増加、経費減少

■ 当期純利益

前回予想比18%増益 (74.5億円 ⇒ 87.9億円)

配当

当社は、連結配当性向をおおむね30%を目途としています。

当期純利益が前回予想を上回ったため、期末配当は、前回予想から30円増配の200円を予定しています。

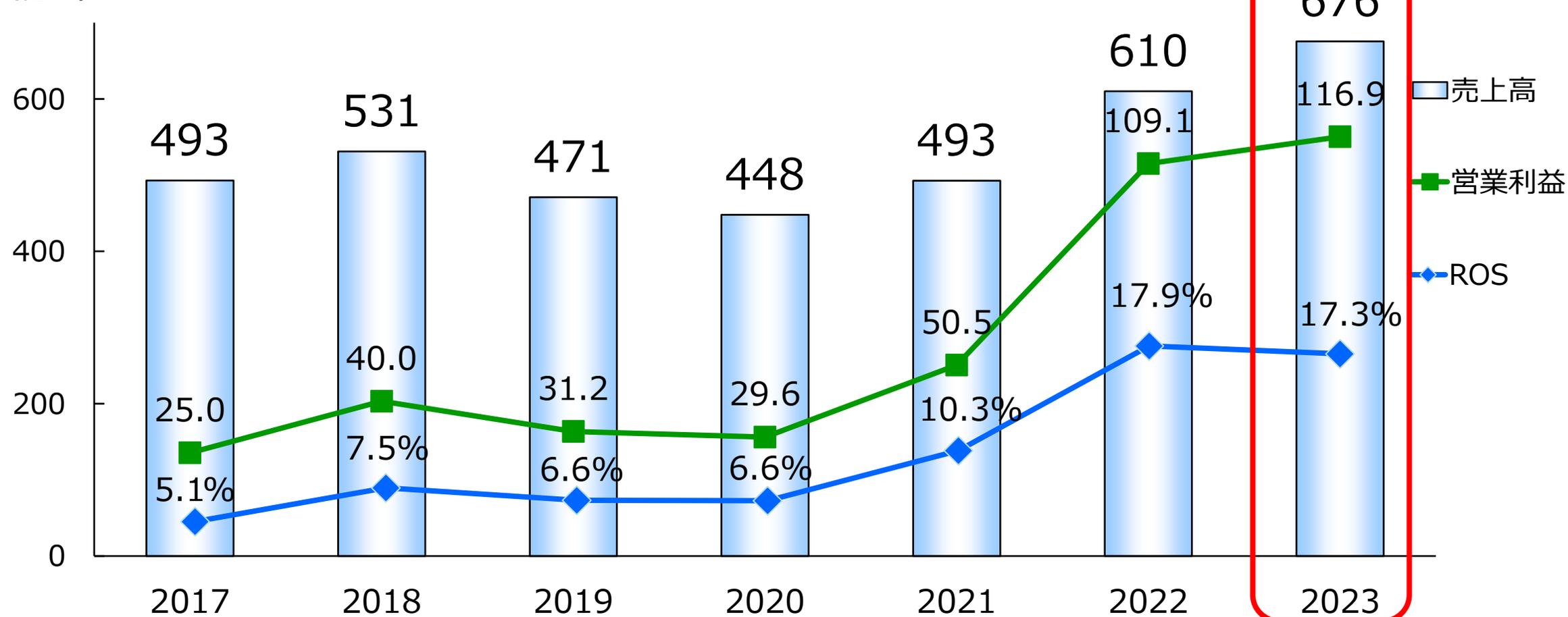
	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
2024年3月期	0円	※ 200円	※ 200円
2024年3月期 (前回予想)	0円	170円	170円
2023年3月期	0円	560円	560円
2022年3月期	0円	230円	230円

※2023年10月1日を効力発生日として1株につき3株の割合で株式分割を実施後の金額
株式分割前の算定では配当600円に相当

売上高・利益・ROS

ROS17.3%

(億円)

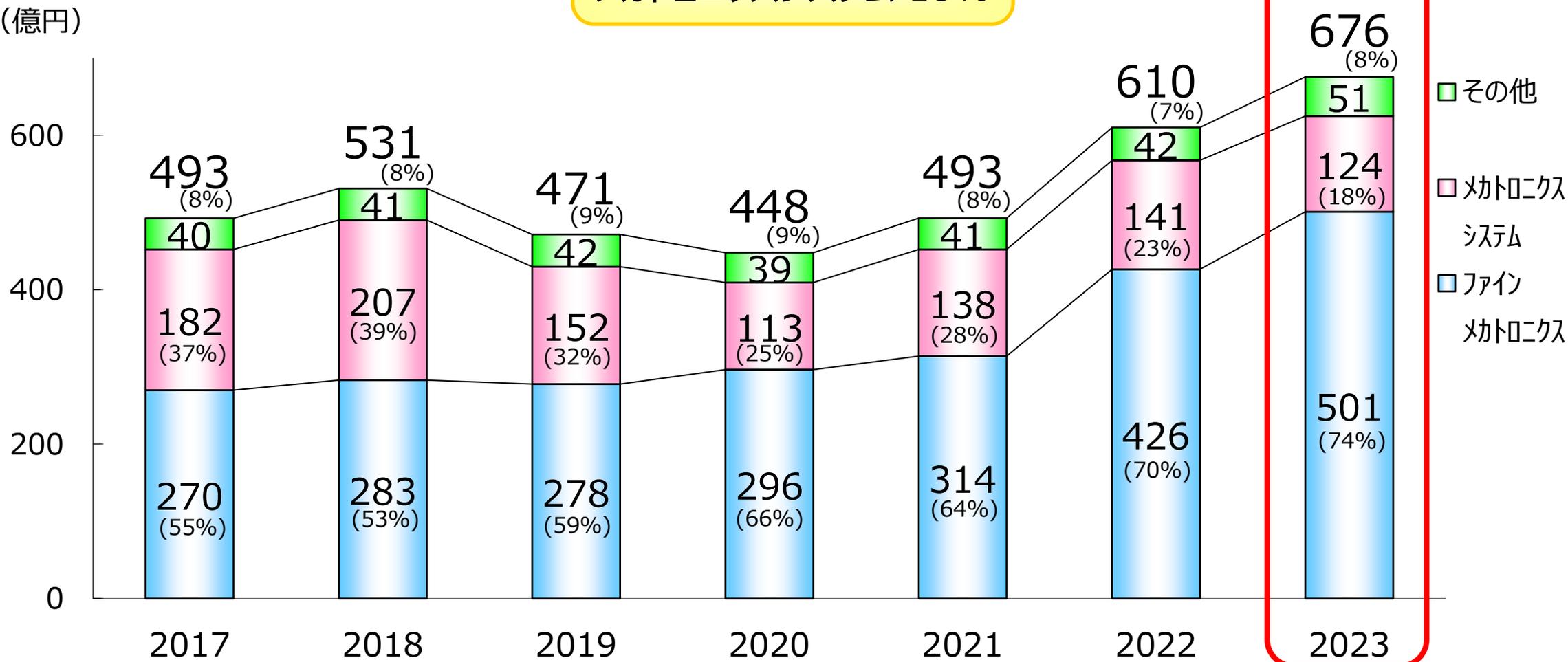


セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 74%
 メカトロニクスシステム 18%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
 メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)

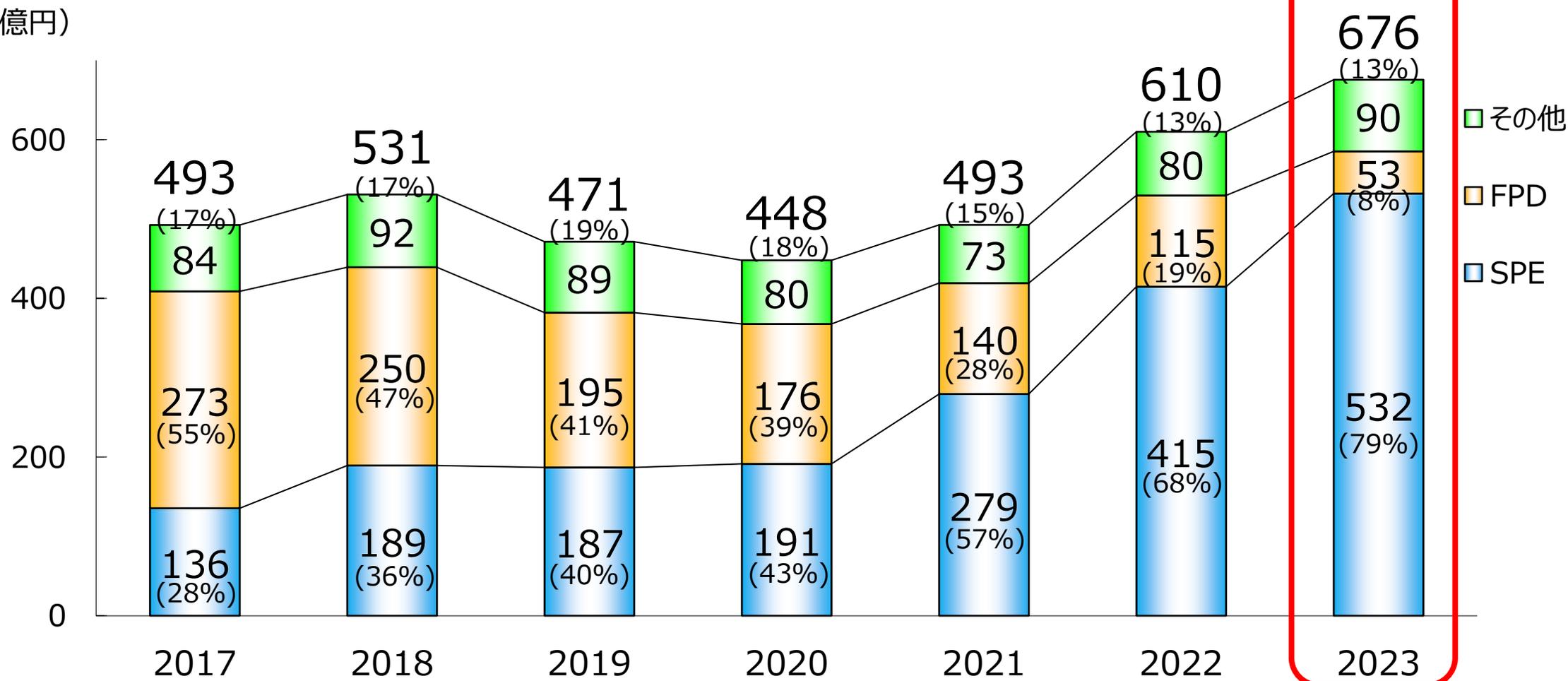


分野別売上高

SPE分野 79%

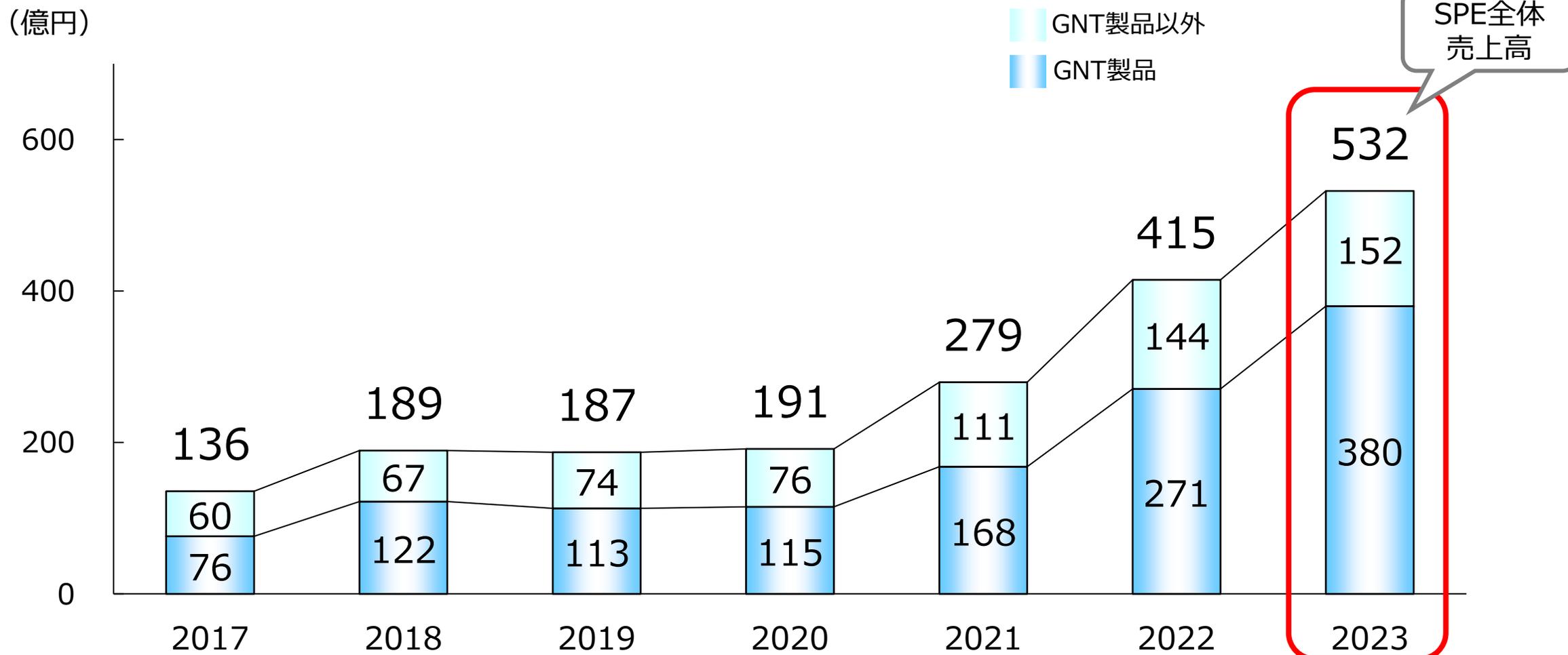
* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

(億円)



*GNT製品：当社グローバル ニッチトップ
対象製品群 (cf.p.32)

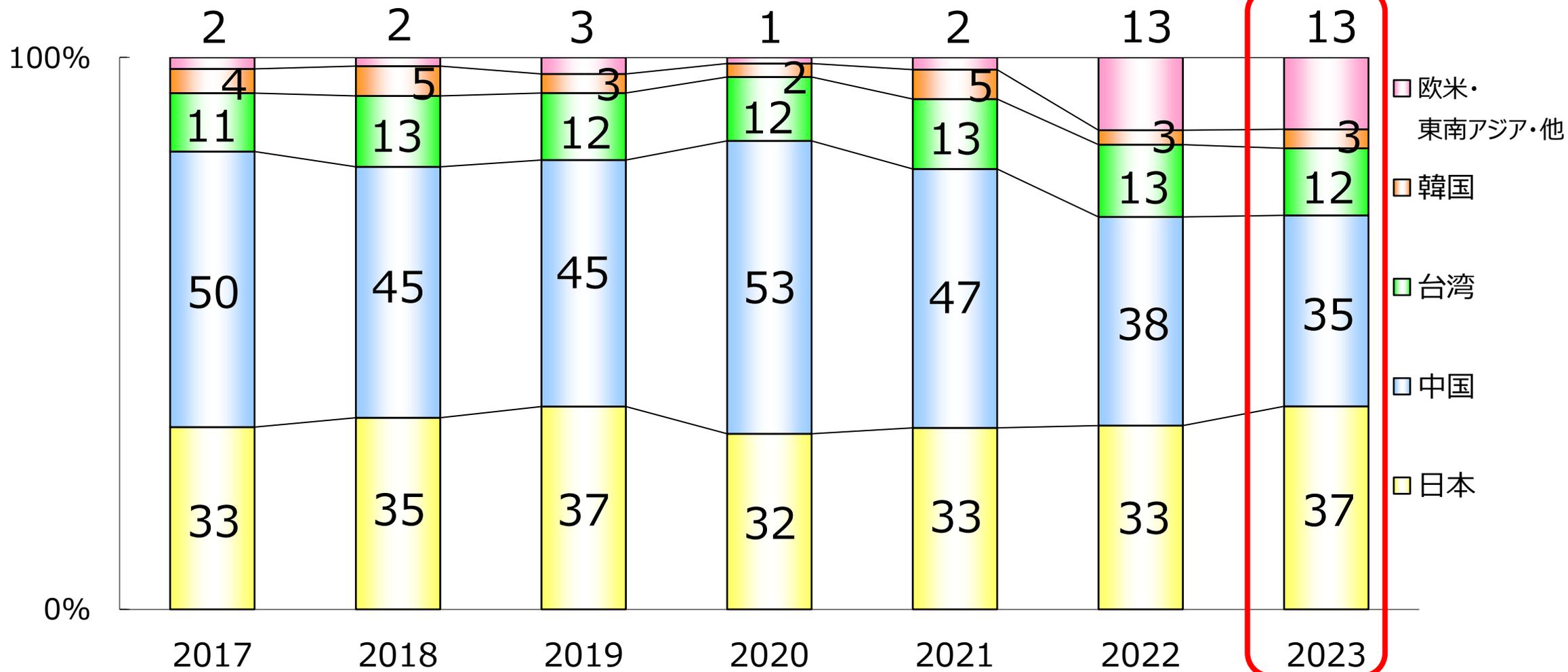
SPE分野売上高



地域別売上高比率

海外向け63% (中国35%)

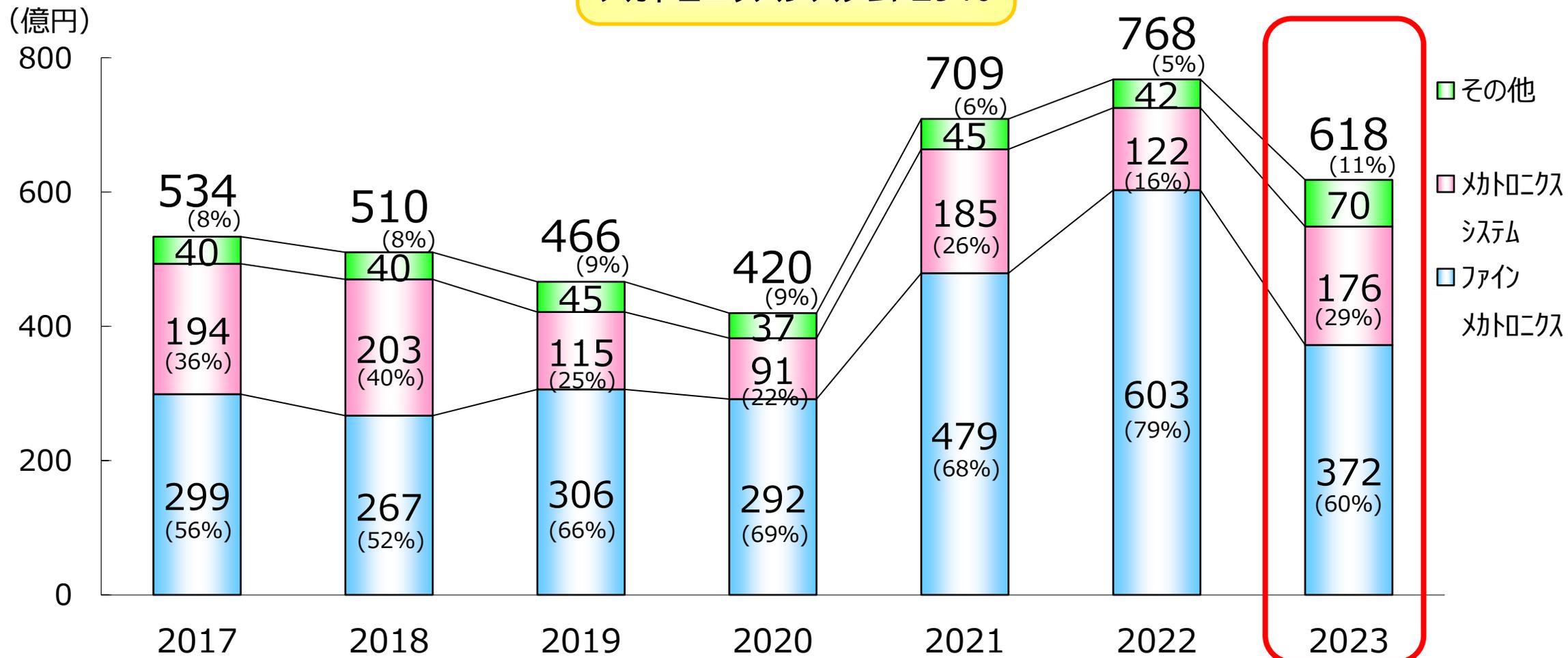
* 仕向地で区分



セグメント別受注高

ファインメカトロニクス 60%
メカトロニクスシステム 29%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

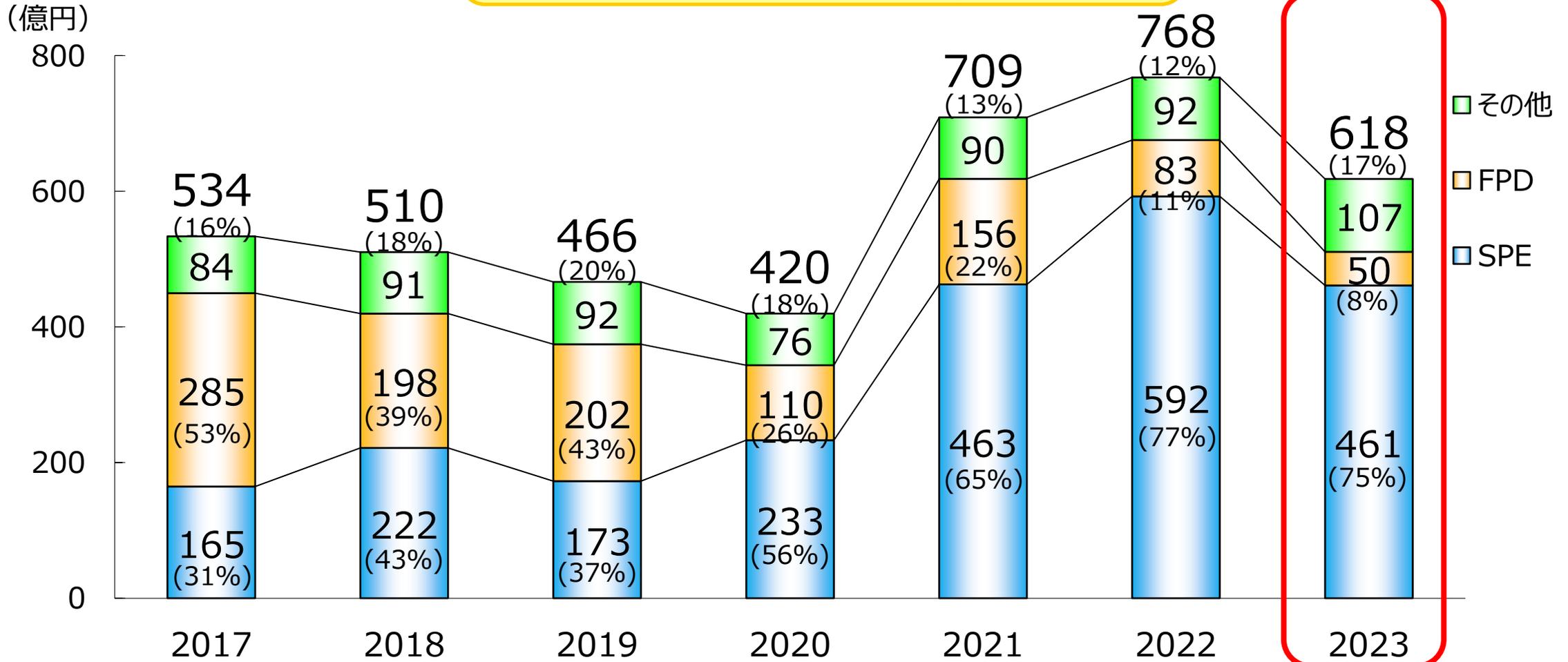


分野別受注高

今後に向けての受注見通し

- ・ウェーハプロセス : レガシー向け、メモリ向けの引合い増加
- ・モジュールプロセス : 生成AI需要増に伴い更なる増加対応
- ・Siウェーハ製造 : 2024年度での回復に期待

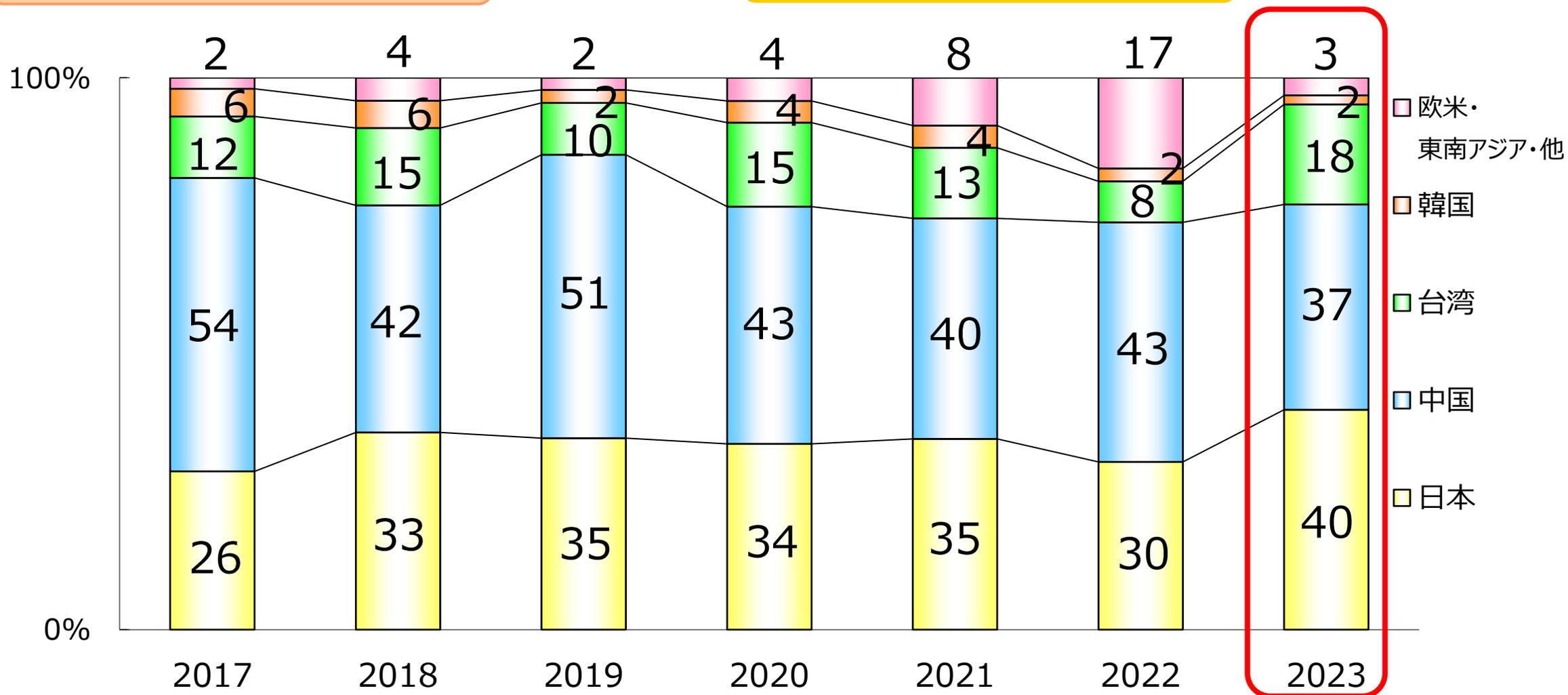
* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置



地域別受注高比率

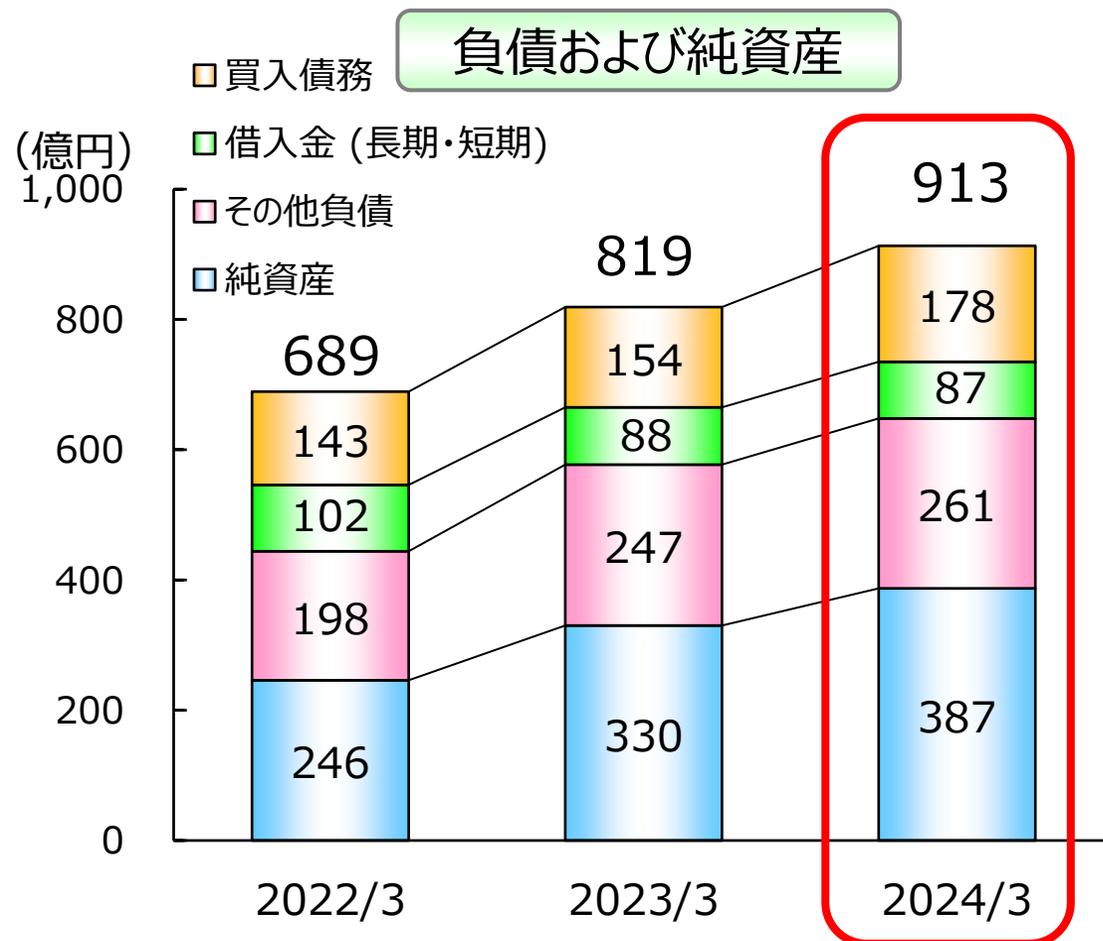
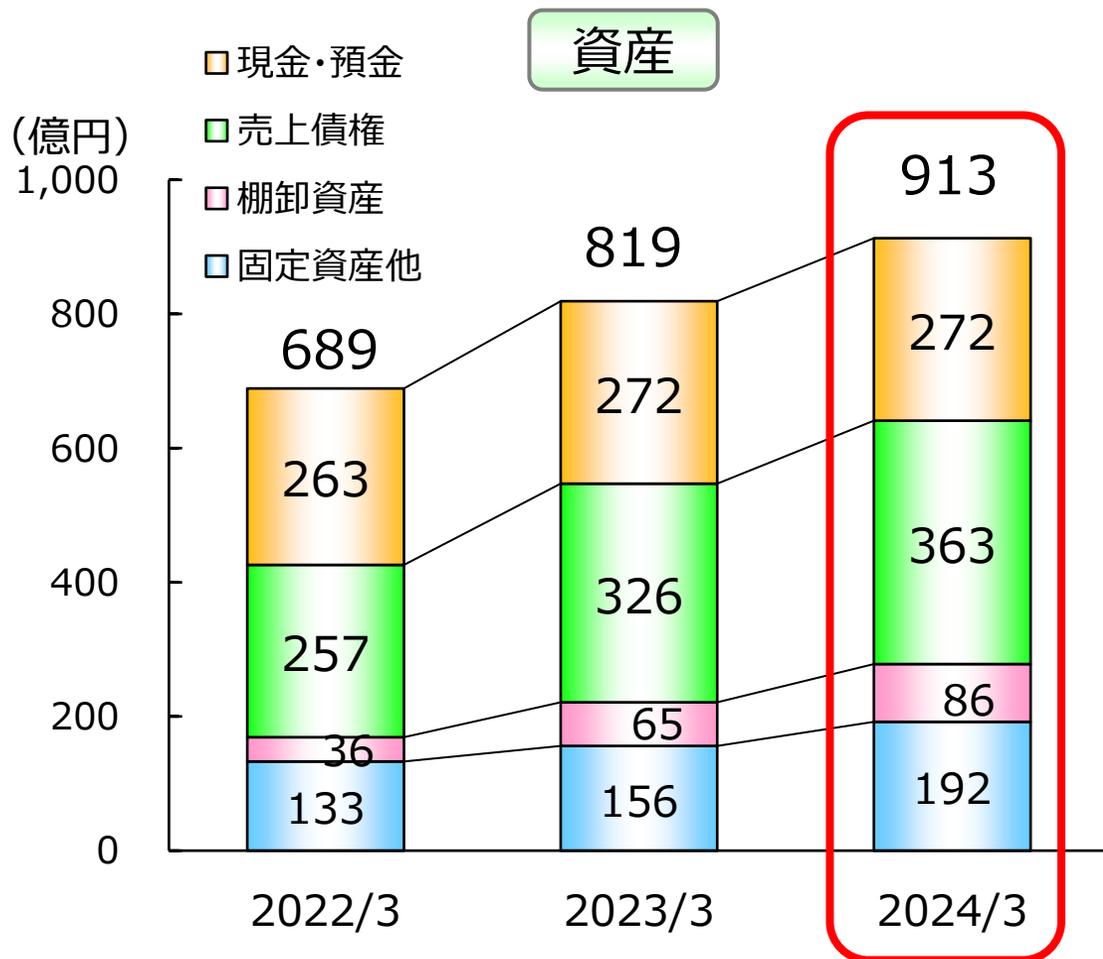
海外向け60% (中国37%)

* 仕向地で区分



貸借対照表

自己資本比率 40% ('23/3) → 42% ('24/3)
 D/Eレシオ 0.27倍 ('23/3) → 0.23倍 ('24/3)
 ROE 31.9% ('23/3) → 24.5% ('24/3)



目次

1. 2024年3月期 連結決算概要
- 2. 2025年3月期 連結業績予想**
3. 中期経営計画の進捗

業績予想サマリー

■ 当社の事業環境

- 半導体業界は、生成AI向けの投資継続。ウェーハプロセス向け中心に中国市場での引合い継続。ロジック向けの他、特に後半からメモリ向け設備投資の回復が見込まれる。
FPD業界は、依然として設備投資が低水準だが、OLEDパネル向け投資に期待。
- 当社として中長期的には市場の伸長とともに成長を目指す。

■ 通期業績予想

- 2024年度 増収減益
売上高 700億円 (4%増)、営業利益 100億円 (14%減)、ROS14.3% (3pt減)
成長投資費用として対2023年度 約20億円増加見込み
(人件費 9億円、研究開発費 7億円、減価償却費 4億円)
- 配当性向は、おおむね35%を目途 (5pt増)

2024年度 業績予想 (2)

業績予想

*24/上、24/下見通しはご参考

(単位：億円)

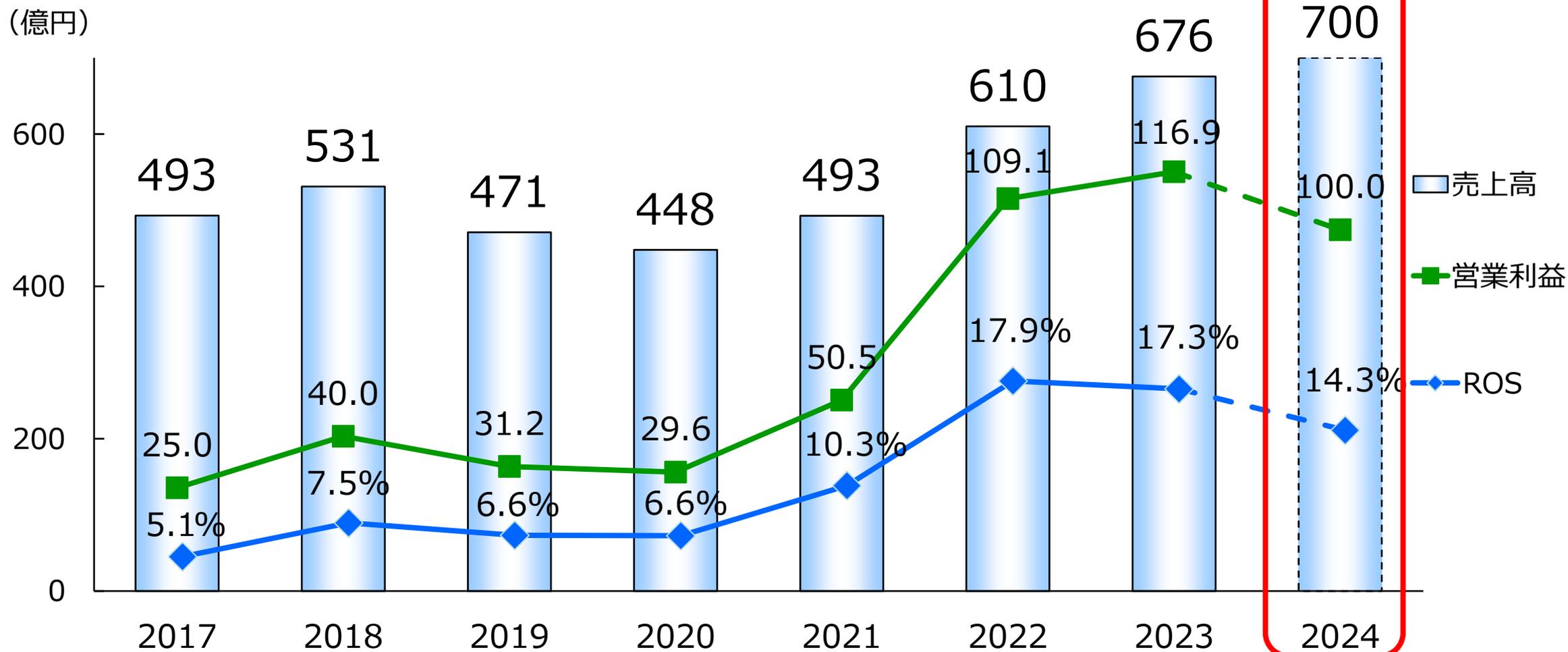
	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023		2023 年度	2024		2024 年度 予想	対前年 増減率
				23/上	23/下		24/上 見通し	24/下 見通し		
売上高	448	493	610	305	371	676	313	387	700	+4%
営業利益	29.6	50.5	109.1	50.2	66.7	116.9	33.4	66.6	100.0	-14%
R O S	6.6%	10.3%	17.9%	16.4%	18.0%	17.3%	10.7%	17.2%	14.3%	-3.0pt
経常利益	28.2	48.8	105.1	50.3	65.8	116.1	30.8	65.2	96.0	-17%
当期純利益	19.7	29.8	92.0	38.7	49.2	87.9	23.0	49.0	72.0	-18%
R O E	9.5%	12.8%	31.9%	-	-	24.5%	-	-	17.6%	-6.9pt
F C F	74.1	77.9	32.0	46.3	-9.7	36.8	-	-	6.0	-31億円

配当予想

当社は、2025年3月期から、連結配当性向をおおむね35%を目途とします。
2025年3月期の期末配当は、193円を予定しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
2025年3月期	0円	193円	193円
2024年3月期	0円	200円	200円

売上高・利益・ROS

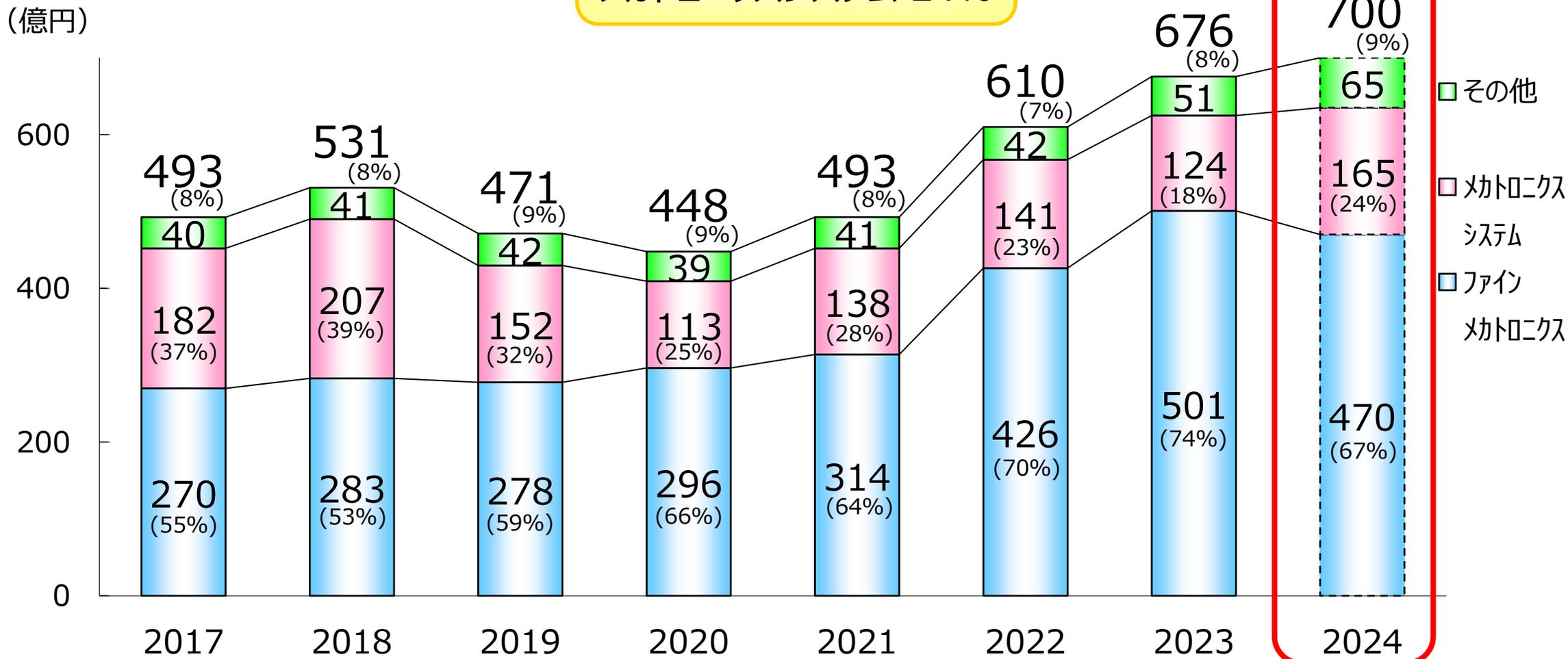


2024年度 業績予想 (5)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 67%
メカトロニクスシステム 24%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



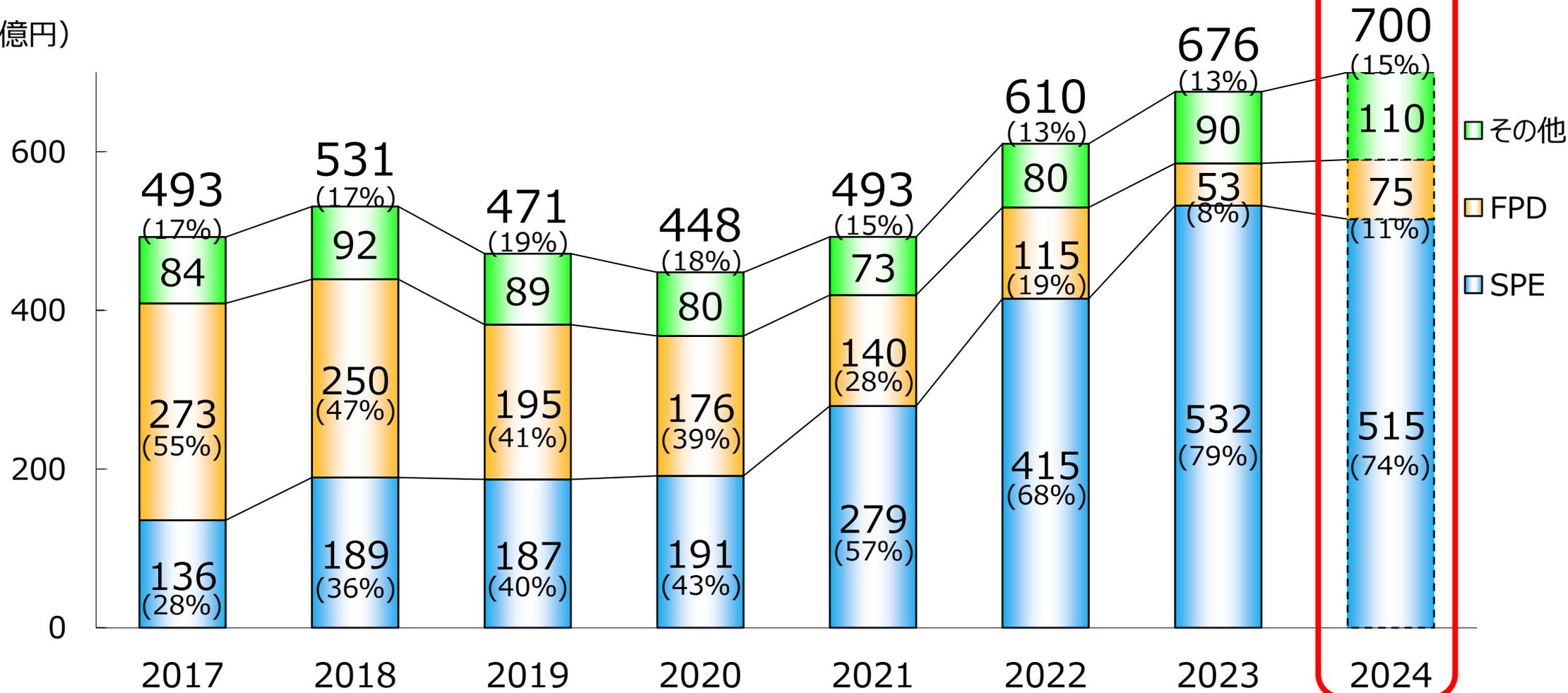
2024年度 業績予想 (6)

分野別売上高

SPE分野 74%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

(億円)

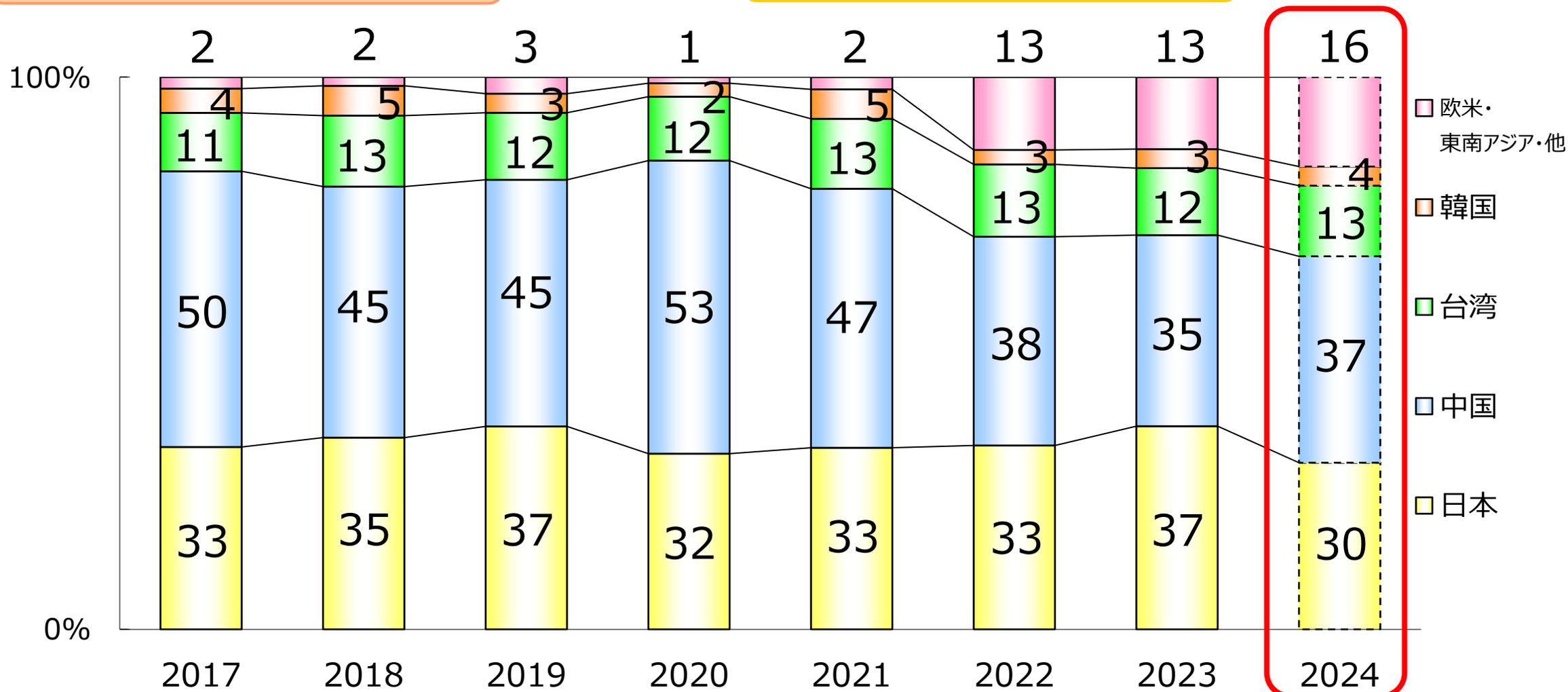


2024年度 業績予想 (7)

地域別売上高比率

海外向け70% (中国37%)

* 仕向地で区分



目次

1. 2024年3月期 連結決算概要
2. 2025年3月期 連結業績予想
- 3. 中期経営計画の進捗**

当社として捉える社会変化・課題

市場

- IoT、(Beyond) 5G、AIやAR、VRなどデジタル社会の進展に伴う半導体・FPD等市場の拡大

技術

- 先端性の高い半導体の開発・製造
- 技術者の育成、確保

環境

- カーボンニュートラル、環境負荷への配慮
- 資源の有効利用

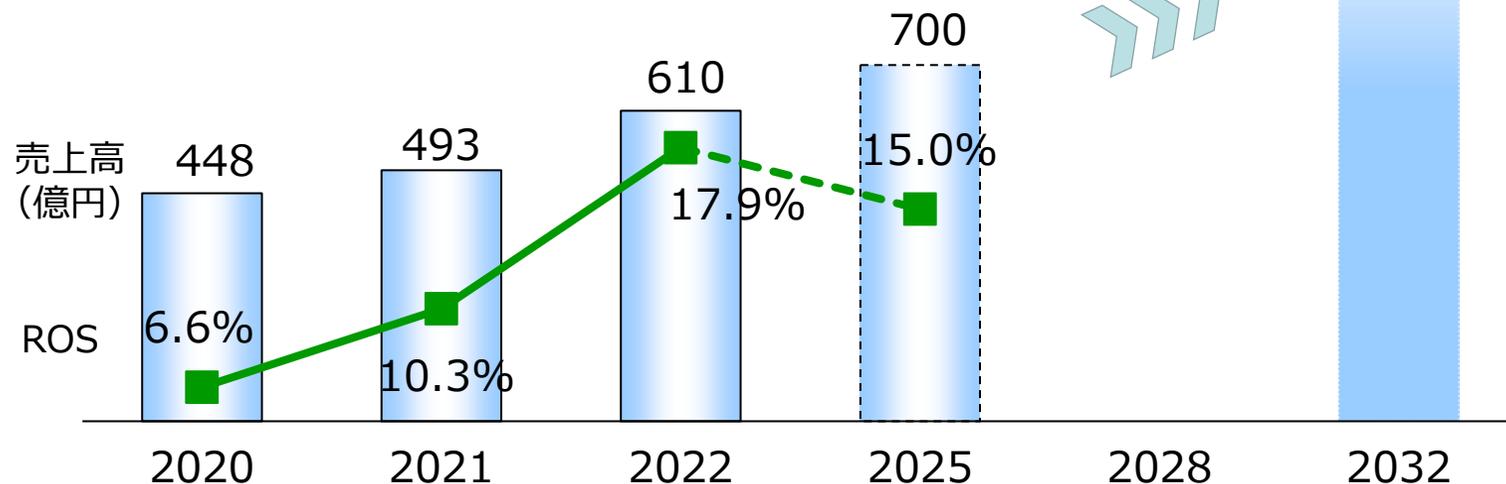
安定供給

- 半導体需要の高まり・確保、供給力不足
- 求められる機能の多様化、高度化
- 地政学的リスクへの懸念

10年後のありたい姿

**社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業**

ビジョン期間内で
 ・売上高1,000億円以上
 ・ROS20%以上
 を目指す



ビジョン達成に向けた重点的取組みの状況

4つの重点的取組み (2023年5月公表)

2023年度実績

ポートフォリオ

- SPE : グローバル ニッチトップ(GNT)製品拡大を核に更なる拡大
- FPD : 新型・次世代向け製品を拡大

- SPE : 分野別比率79%、SPE分野の内GNT比率71%
- FPD : 顧客との評価が着実に進行

技術

- 課題・ニーズの把握と、解決に繋がる技術開発、製品・サービスへの展開
- 製品とサービスのより一体的な提案により、全体付加価値向上

- 顧客層拡大し、受注・評価実績増加
- 顧客への付加価値に立ち返り、製品・サービス一体提案の具体化検討開始

人財

- ビジョン達成を担う人財力強化、持続的成長に向けた積極採用
- DX推進を含む業務生産性向上

- 「芝浦ビジョン2033」を実現する人財像の策定
- 評価制度の見直し実施

財務

- 成長性と資本効率の両面を意識した、財務規律の堅持
- 事業成長・株主還元を重視した、キャッシュアロケーションの実現

- 自己資本比率40.3% ('23/3) → 42.4% ('24/3)
- 配当性向30%→35%に引上げ('25/3月期～)

中期経営計画方針

2023.4.1 – 2033.3.31

芝浦ビジョン2033達成

**2023-2025
芝浦ビジョン2033
Phase.1**

2026-2028
芝浦ビジョン2033
Phase.2

2029-2032
芝浦ビジョン2033
Phase.3

＜2025年度＞ 2023年5月公表

売上高	700億円
営業利益	105億円
R O S	15%
R O E	17%

**2024年度の達成状況と
市場環境をもとに再設定**

「持続的成長に向けた投資」を柱として、
次の成長に向けた土台強化を進め
再び営業利益100億円超を目指す

4
つ
の
柱

- ① SPE分野の更なる拡大
- ② 持続的成長に向けた投資
- ③ 課題とニーズの把握
- ④ マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進

中期経営計画進捗 (1)

中期経営計画の進捗

2023年度は中計公表を上回る実績
2024年度予想も中計公表より上方へ見直し

*1: 2024年2月公表

(単位: 億円)

	2023 年度予想 *1	2023 年度実績	2024 年度予想	2023年5月 中計公表		
				2023	2024	2025
売上高	660	676	700	590	680	700
営業利益	105.0	116.9	100.0	73.0	95.0	105.0
R O S	15.9%	17.3%	14.3%	12.4%	14.0%	15.0%
経常利益	100.0	116.1	96.0	-	-	-
当期純利益	74.5	88.1	72.0	-	-	-
R O E	21.0%	24.5%	17.6%	15.0%	17.0%	17.0%

分野別市況と当社の方向性

*1 出典：TechInsights Inc. 2024-3

*2 出典：Display Supply Chain Consultants, LLC 2024-4
いずれも暦年、グラフは当社にて作成

S
P
E

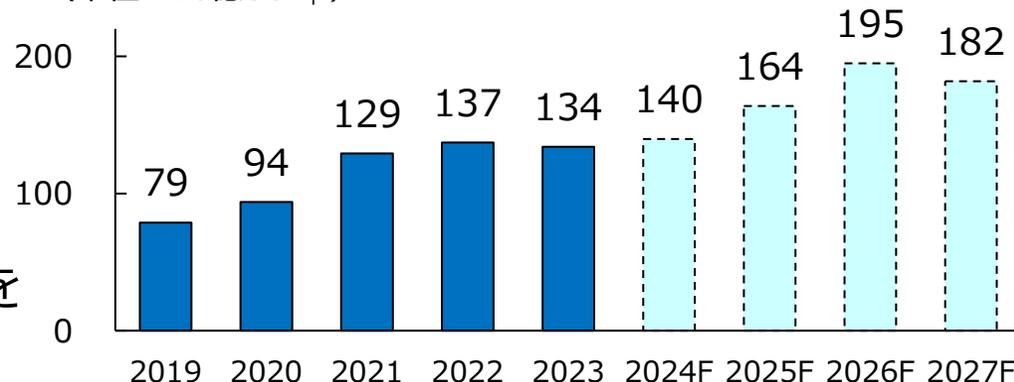
- 前工程ではウェーハプロセス向け中心に中国で引合いが継続、市場全体の早期回復にも期待
- 後工程では引き続き生成AI市場向けが活況となる見込み
- 輸出管理強化、部品・部材の調達状況などリスクになり得る事象は継続注視



今後も実績のある装置の拡販・シェア拡大と、新たなGNT製品を含む次世代・先端半導体対応装置の開発・販売に注力

■ 半導体製造装置 売上高予測 *1

(単位：10億US \$)



F
P
D

- 2024年は2023年に比べ46%投資が増加する予測、まずはITパネル用大型サイズOLED投資計画の具体化に期待
- TVパネル需要は引続き低調だが、顧客の投資に合わせ実績を活かした受注継続

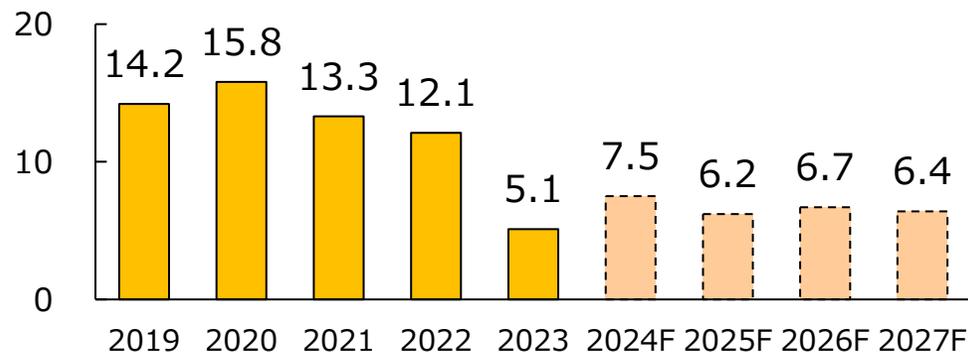


主要サプライヤとしてのポジションを堅持し、新型・次世代ディスプレイ向け製品の開発・顧客との評価・拡販に注力

■ FPD製造装置 売上高予測 *2

(単位：10億US \$)

(納入基準、2Q決算
説明資料まで据付基準)



SPE分野工程別 主要製品群

Siウェーハ製造

枚葉式Siウェーハ
洗浄装置



フォトマスク製造

マスク
エッチング装置



マスク洗浄装置



モジュールプロセス

高精度2.5Dボンダ

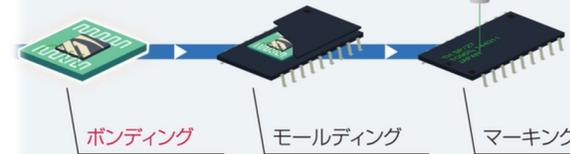
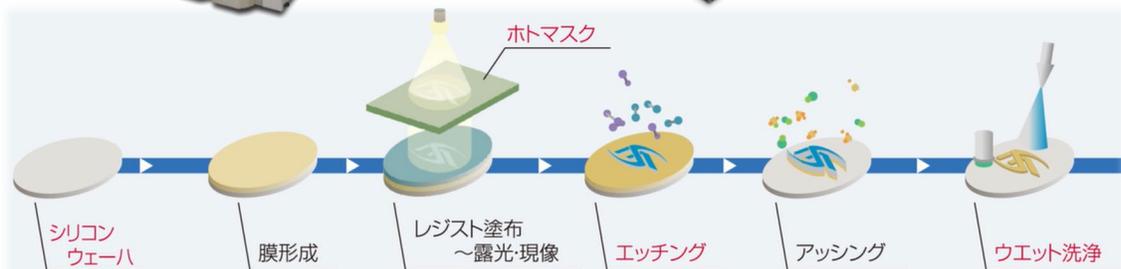


超高精度ハイブリッドボンダ



高精度Fo-PLPボンダ

* 当社グローバル ニッチトップ
対象製品群 (GNT製品)
が属す4工程
(掲載機種は一例)



その他の注目製品



ケミカルドライエッチング装置

ウェーハプロセス



枚葉式リン酸
エッチング装置

新しいGNT製品

創出・拡大に
注力

- 引き続き4工程の製品群を
GNT製品群に位置付け
- GNT製品群を核としたSPE分野
の拡大を追求
- 新しいGNT製品を創出

中期経営計画進捗（4）

中計公表値と実績・計画

国内外の新規拠点含め、GNT製品のシェア拡大を進め、中計公表値・計画を上回る成果を目指す

2023公表値と実績

2024計画

2025計画

受注面

(公表値
非公表)

- 実績618億円
- Siウェーハ製造向けで、顧客の設備投資計画の見直しがあり、想定よりさらに受注規模減少（↓）
- 先端パッケージ向けボンダ需要増（↑）

- 半導体前工程、後工程とも顧客層と用途拡大へ一層注力
- 足元ではウェーハプロセス向け（枚葉式リン酸エッチング装置）、先端パッケージ向けボンダの引合いが強い

- SPE分野は堅調に受注継続、FPD分野は低水準が継続。半導体は市場の上振れとともに拡大傾向

売上面

- 中計公表590億円に対し676億円（+15%）
- 半導体前工程の前年度の受注とその後進捗、半導体後工程の受注増が寄与

- 中計公表680億円から700億円へ変更（+3%）
- 枚葉式リン酸エッチング装置の受注増による寄与を見込む

- 23年5月時点 中計公表700億円
- 2023、2024の受注状況を踏まえ、目標値を再設定

営業利益面

- 中計公表73.0億円に対し116.9億円（+60%）
- 半導体分野の売上高増（↑）
- 経費減少も寄与（↑）

- 中計公表95億円から100億円へ変更（+5%）
- 主に上記売上高増加による営業利益増加を見込む

- 23年5月時点 中計公表105億円
- 売上高同様に営業利益も目標値を再設定
- 引続き利益率アップに取り組む

SPE前工程トピックス

ウェーハプロセス

ロジック/ファウンドリ
(CPU、GPU等)
メモリ (DRAM)

- 枚葉式高温リン酸エッチング装置は先端デバイスに加えレガシー製品やメモリ向けへの用途拡大に期待



枚葉式リン酸エッチング装置

フォトマスク製造

ブランク、PSM、
EUVマスク
次世代EUVマスク

- ドライエッチング装置は次世代EUV対応とレガシー製品向けで受注伸長、シェアアップ
- 洗浄装置は凍結洗浄技術搭載の新機種を今年24年に上市



マスクエッチング装置

Siウェーハ製造

Si、SiC、
各材料のウェーハ

- 当社独自の洗浄技術をSiウェーハ洗浄プロセスに展開
- 基礎評価を完了し、25年の上市を目指しユーザー評価を開始



枚葉式Siウェーハ洗浄装置

SPE後工程トピックス

モジュールプロセス



高精度2.5Dボンダ
TFC-6500
2.5D、GPU、AIチップ

- 2.5D、生成AI向けGPU市場で高評価、多くの受注を獲得中
- 接続基板（インターポーザ）の進化に伴う次期高性能ボンダ開発中



高精度FO-WLPボンダ
TFC-6100W
FO-WLP、APモジュール

- アプリケーションプロセッサをはじめ、高密度FO-WLP市場で豊富な実績
- シリコンブリッジを想定した次世代ボンダを開発



超高精度ハイブリッドボンダ
TFC-6800
D2W-Hybrid、チップレット

- 従来比3倍の高い生産性を実現
- 自社製前処理（洗浄、プラズマ）システムの研究開発進行中



高精度Fo-PLPボンダ
TFC-9300
FO-PLP、ブリッジ実装

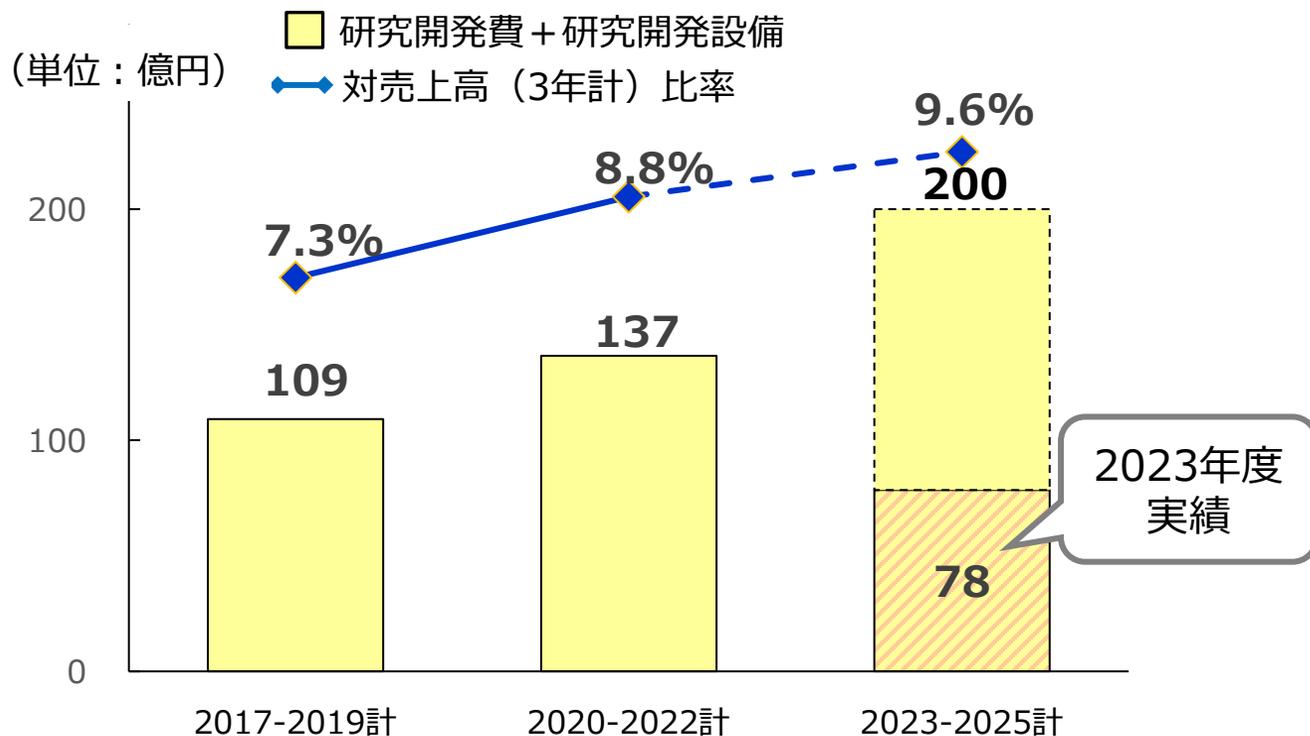
- 大型基板へ高精度で実装、高い技術力と実績で基板実装分野へ進出
- ブリッジ実装、大きなチップの加熱実装を視野に入れた派生機種を展開

持続的成長に向けた投資

■ 研究開発費・研究開発設備

- 中計計画に沿いSPE分野中心に実行中

■ 研究開発関連投資額・売上高比率推移 (中計期間別)



■ 建屋整備 (横浜事業所、さがみ野事業所)

- クリーンルーム増設に向け計画どおり進捗中
- 横浜事業所 研究開発新棟
2025年8月 竣工予定
- さがみ野事業所 クリーンルーム (650㎡)
2024年4月 稼働開始



横浜事業所
研究開発新棟
完成イメージ図

(3階建て、延床面積 約4,300㎡)

サステナビリティ経営関連トピックス

気候変動への対応 環境負荷低減

環境調和型製品の割合
23年度実績：対売上高97.6%
(目標85%以上)

事業所CO2排出量*1
23年度実績：前年度比5.1%削減
(2030年度までに2019年度比50%削減)

再資源化率*2
23年度実績：99.9%
(再資源化率99%以上を維持)

*1: Scope1+2

*2: 再資源化量／廃棄物発生量

多様な人財が活躍できる 環境づくり

- 「芝浦ビジョン2033」を実現する*3
「当社が求める人財像」の策定と、
それに基づく評価制度見直し
- 賃金水準アップ
(23年度比 6.27%増)
- 年代別キャリア研修新設など教育・
研修の拡充 (従業員一人当たり平均
研修時間 22年度比 23%増)
- 育児に関わる休職制度改善
(女性育児休職者 復職率100%継続、
男性育児休職者 22年度比 22%増)

*3: 実績値はいずれも当社単体

サプライチェーン マネジメントの強化

未来を拓くパートナーシップ構築
推進会議の趣旨に賛同し、
「パートナーシップ構築宣言」
を公表

ガバナンスの強化

経営トップ及び将来の経営層
後継者候補人財の充実を図り、
経営人財パイプラインを構築するため、
サクセッションプランを策定

ブランドメッセージ制定

- 当社の強みである「技術力」「人」を活かし「社会に貢献する」という思いを込めて制定
- お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、豊かな社会の実現に向けて環境・社会・経済の持続可能性を意識した経営を推進



ブランドメッセージ：「この先もずっと、人と技術で社会を支える。」

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

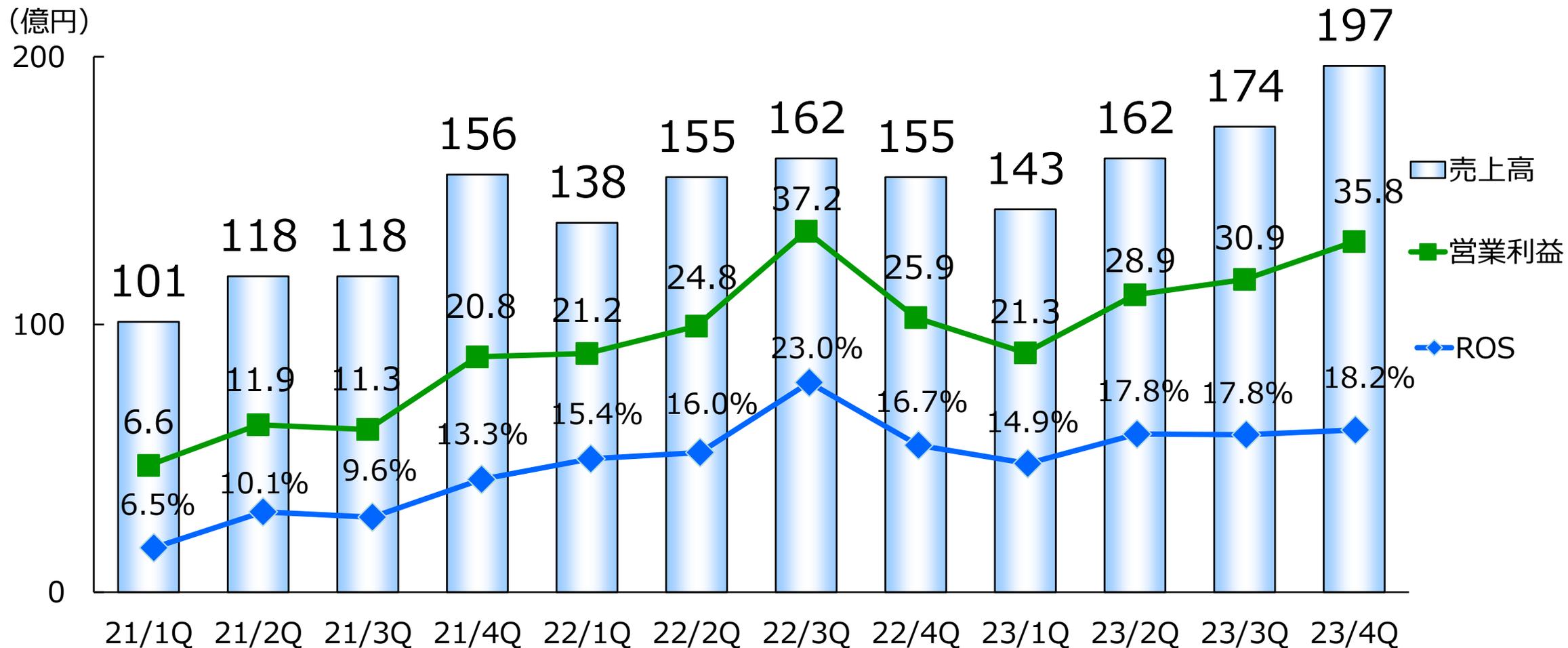
「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承ください。

END

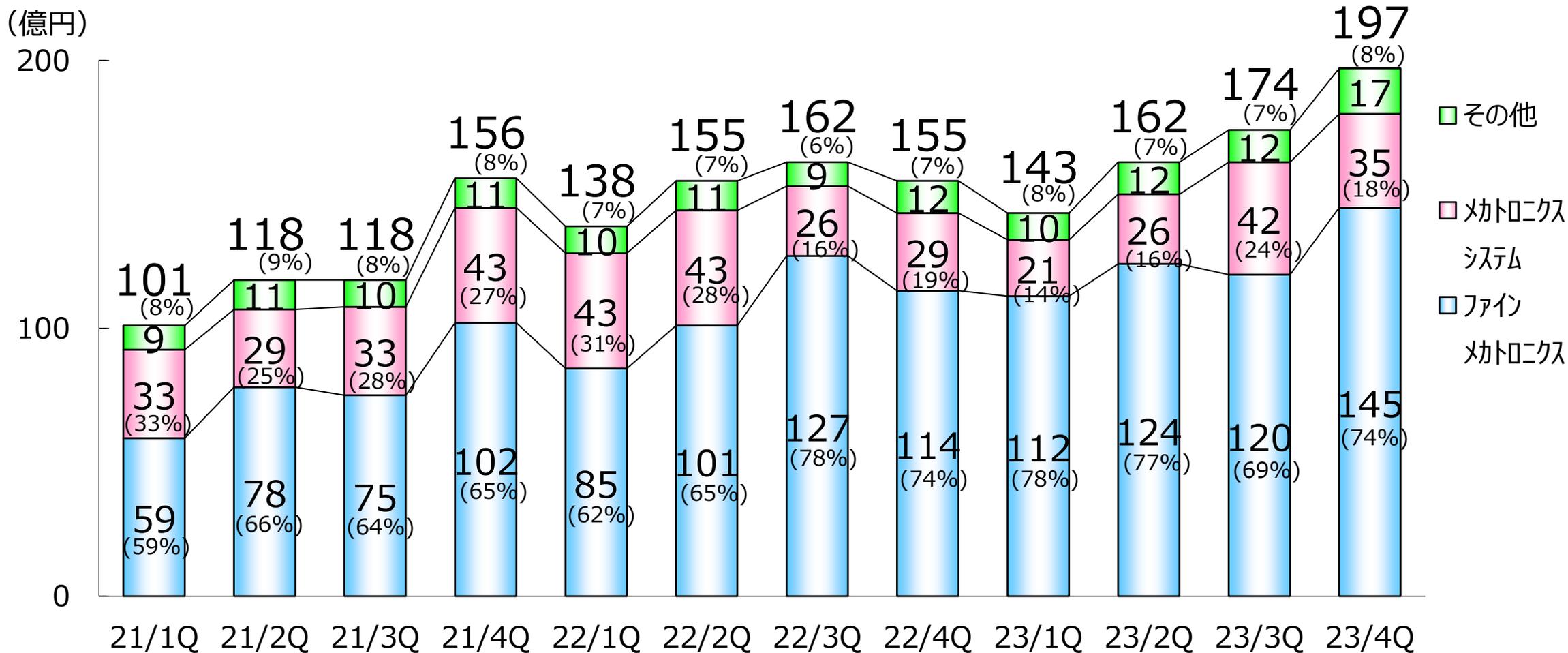
Appendix

売上高・利益・ROS



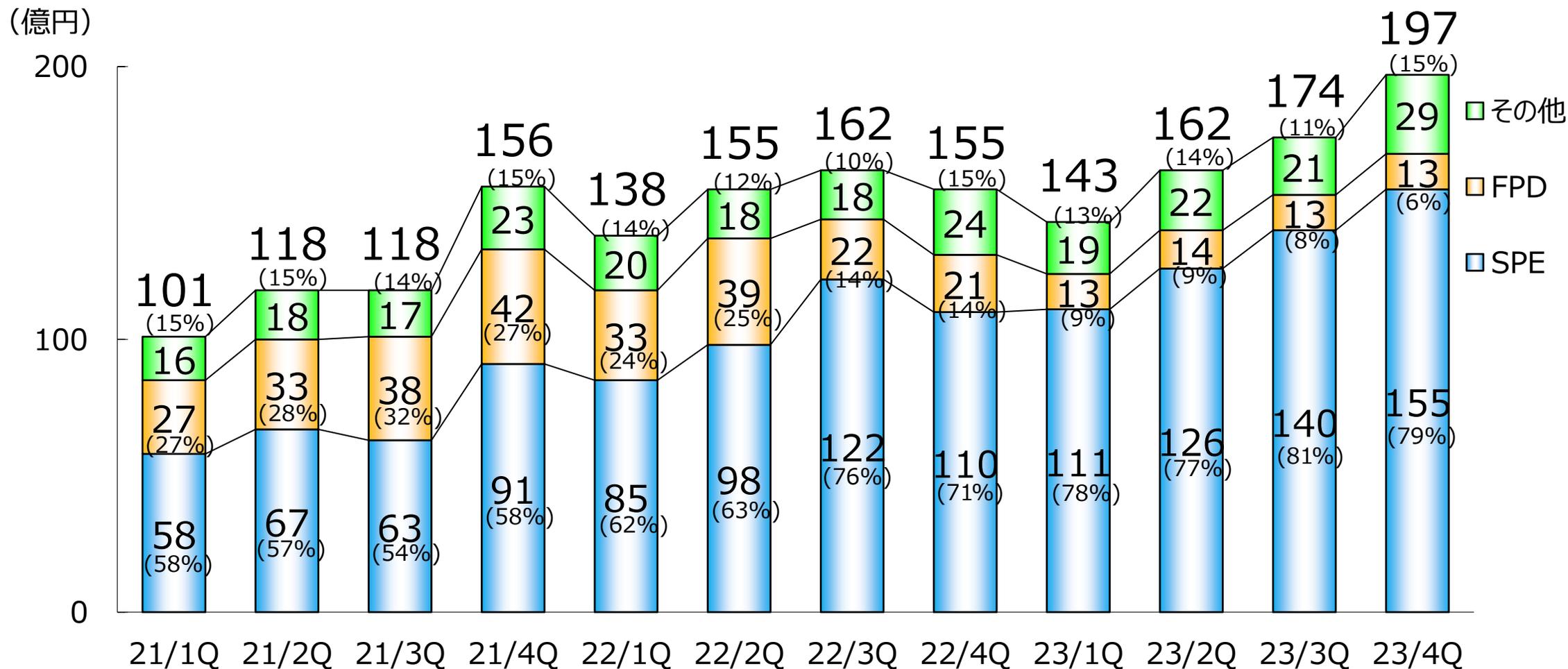
セグメント別売上高

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



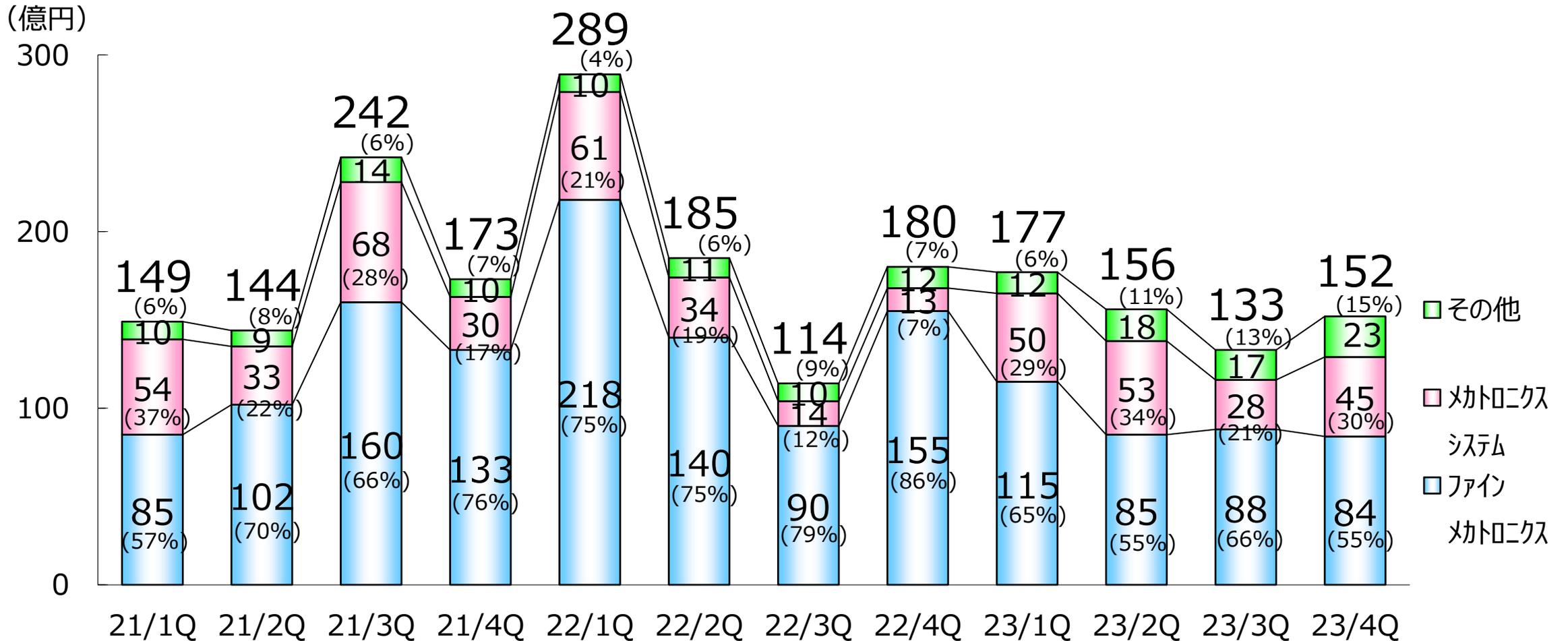
分野別売上高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置



セグメント別受注高

* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置
メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

